SMコンタクト
SM contact

SM-485030-I

RoHS 指令準拠 compliant

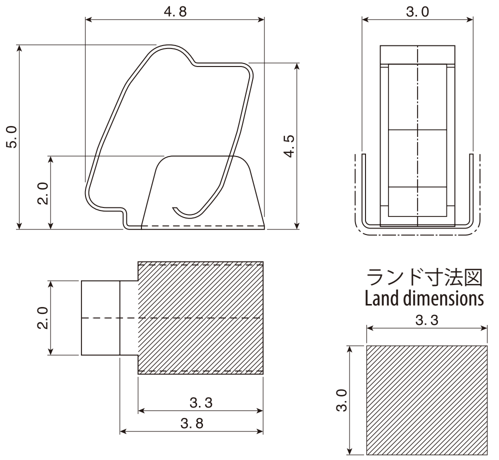
- 材　　質 /Material .... リン青銅（t=0.08mm）Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating .... 全面: Niメッキ　Whole surface: Ni plating
半田付部:Snメッキ　Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range .... 高さ =2.1 ～ 4.8mm　Height: 2.1 mm to 4.8 mm

用　途　Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

[単位 Unit:mm]



標準梱包数量　Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数　量 Quantity	備　考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ（リール） 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	28,000ヶ（外箱） 28,000/box	14リール / 1箱 梱包 Fourteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.

特　性　Physical properties

<table>
<tr><th>試験項目
Test item</th><th>性能・規格
Performance/specifications</th><th colspan="7">試験方法及び条件</th></tr>
<tr><td>初期抵抗値
Initial resistance</td><td>0.05 Ω以下
0.05 Ω or less</td><td colspan="7">測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">圧縮荷重
Compressive load</td><td rowspan="5">0.5N ～ 1.2N 以下
0.5 N to 1.2 N</td><td colspan="7">測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mm～2.7mmに圧縮した時の反発力を測定する。</td></tr>
<tr><td>測定方法</td><td colspan="6">製品を測定用基盤に半田付けし、製品高さを 2 .7mmに圧縮した時と 4 .7mmに圧縮した時の荷重をプッシュプルゲージを使用し手作業で測定する。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">測定結果</td><td></td><td>サンプル 1</td><td>サンプル 2</td><td>サンプル 3</td><td>サンプル 4</td><td>サンプル 5</td><td>平　均</td></tr>
<tr><td>4.7mm 時</td><td>0.6N</td><td>0.6N</td><td>0.5N</td><td>0.5N</td><td>0.6N</td><td>0.56N</td></tr>
<tr><td>2.7mm 時</td><td>1.2N</td><td>1.1N</td><td>1.1N</td><td>1.2N</td><td>1.1N</td><td>1.14N</td></tr>
<tr><td>高温試験
High temperature test</td><td>0.05 Ω以下
0.05 Ω or less</td><td colspan="7">製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。　処理温度：85℃　処理時間：500hr</td></tr>
<tr><td>耐湿試験
Humidity test</td><td>0.05 Ω以下
0.05 Ω or less</td><td colspan="7">製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。　処理温度：65℃/95% RH 処理時間：500hr</td></tr>
<tr><td>低温試験
Low temperature test</td><td>0.05 Ω以下
0.05 Ω or less</td><td colspan="7">製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。　処理温度：-40℃　処理時間：500hr</td></tr>
<tr><td>ヒートサイクル試験
Temperature cycle test</td><td>0.05 Ω以下
0.05 Ω or less</td><td colspan="7">製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。　処理温度：-40℃(1hr)～85℃(1hr)
処理時間：100 サイクル</td></tr>
<tr><td>圧縮永久歪率測定
Compression set measurement</td><td>30% 以下
30% or less</td><td colspan="7">製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。　処理温度：-40℃(1hr)～85℃(1hr)
処理時間：12 サイクル　歪率(%)＝(t0-t1)/(t0-t2)　x100　　t0：初期高さ　t1：処理後高さ　t2：スペーサー</td></tr>
<tr><td>半田濡れ性試験
Solder wettability test</td><td>浸漬部分95%以上
At least 95% of the immersed area is wet with solder.</td><td colspan="7">半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。　半田：PF305　フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。　半田温度：245±3℃　浸漬時間：3 sec.</td></tr>
</table>